**Samtec lancia progetti di riferimento Analog over ArrayTM**

**I nuovi progetti di riferimento rendono possibile la propagazione di segnali di potenza, analogici e digitali ad alta velocità attraverso un singolo connettore ad array.**

[**New Albany, INDIANA**]-- Samtec, Inc., leader nel settore dei connettori, ha perfezionato i suoi array di pin scoperti per l’uso simultaneo di segnali di potenza, analogici e digitali. Nuovi progetti di riferimento consentono agli array di connettori altamente performanti, dall’affidabilità comprovata sviluppati da Samtec, come il [SEARAY](https://www.samtec.com/connectors/high-speed-board-to-board/high-density-arrays/searay)TM, di supportare segnali analogici.

Concepiti per l’uso in applicazioni RF ad alta densità, i nuovi progetti di riferimento Analog over Array permettono a connettori con schiere di pin scoperti di supportare sia segnali digitali e analogici differenziali o sbilanciato sia segnali di potenza. L’affidabilità di questi connettori con array ad alta densità è già stata comprovata in circuiti di potenza e digitali altamente performanti, ad alta velocità; ora, i percorsi di “massa” differenziali possono essere utilizzati per supportare SoC a RF e applicazioni quali wireless 5G, dispositivi PHY/MSO remoti, radar ad array di fase, test e misure e satelliti LEO/MEO.

Le prestazioni sono specificate a:

• Larghezza di banda di 8 GHz

• Impedenza del sistema pari a 50 ohm per configurazione sbilanciata e 100 ohm per configurazione differenziale

• Attenuazione di ritorno pari a -12 dB fino a 4 GHz e -10 dB fino a 8 GHz

• Isolamento tra canali per prevenire diafonia: -69 dBc fino a 4 GHz e -63 dBc fino a 8 GHz

Il [progetto di riferimento](https://suddendocs.samtec.com/testreports/20230809_t-3585732_aoac_seam-035_seaf-065_10mm_rev3.pdf) include una mappatura dei pin consigliata nell’ambito di un report di caratterizzazione completo. Sono in fase di sviluppo ulteriori progetti di riferimento per applicazioni fino a 40 GHz. Per maggiori informazioni sulla selezione dei materiali della scheda di circuiti stampati e sull’ottimizzazione dell’impilamento e della struttura di lancio inviare un’e-mail a [sig@samtec.com](mailto:sig@samtec.com).

Fondata nel 1976, Samtec è una multinazionale a proprietà privata che produce una vasta gamma di soluzioni di interconnessione elettroniche – da scheda a scheda ad alta velocità, cavi per frequenze elevate, dispositivi ottici da pannello e mid-board, componenti e cavi RF di precisione, per impilamento flessibile ultracompatti/estremamente robusti. I centri tecnologici Samtec sviluppano tecnologie, strategie e prodotti al fine di ottimizzare sia le prestazioni che il costo dei sistemi – dalla semplice piastrina a un’interfaccia distante 100 metri – e tutti i punti di interconnessione intermedi.

A close-up of several electronic components

Description automatically generated